A 3D rendering of a circuit board with glowing blue lines and components. The board is dark, and the components are highlighted with bright blue light. The background is a dark blue gradient with glowing circuit traces.

DAEDUCK ELECTRONICS

앞선 기술과 인간 중심경영으로 미래를 창조합니다.

대덕전자 (주)

2020년 4분기 경영실적

2021.03

Disclaimer

본 자료는 투자자의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 자료입니다.

당사는 20년 5월 1일을 기준으로 회사가 분할 되어 신규설립 됨에 따라,

공시기준으로는 20년 5월 이후에 해당하는 실적 부터 확인됩니다.

그러나, 사업회사의 경영은 지속되고 있음을 감안하여, 기존 투자자들의 편의를 도모 코져,

실적 사항은 분할 전 실적을 포함한 사업 연속성 기준으로 작성 되었습니다

또한, 내용에서 언급하는 미래에 대한 예측 정보는 투자자 편의를 위한 참고사항으로,

향후 경영환경과 시장의 변화에 따라 차이가 발생할 수 있음을 양해 바랍니다.

당사는 본 자료의 내용에 있어 투자자에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

또한 당사는 투자자 여러분의 독립적인 판단에 의하여 투자가 이루어 질 것으로 신뢰 합니다.

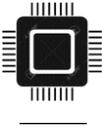
본 자료의 재무자료는 K-IFRS 별도기준 입니다.

회사개요 및 사업소개

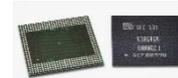
[회사개요]

회사명	대덕전자 (주)
대표	신영환
설립일	2020년 5월 1일 (회사분할) ※최초설립 : 1972년 8월
신규상장일	2020년 5월 21일
자산규모	7,974억 (2020.12)
임직원수	2,397명 (2020.12)
본사위치	경기도 안산시 단원구 강촌로 230
해외거점	대덕 베트남 대덕 필리핀

[사업소개]



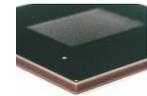
BGA /
Flip Chip



DRAM



Nand



AI, Controller, AP

· 메모리 및 비메모리 用 반도체 Package 기판



Module
SiP



Camera Module



Flexible Cable



Wearable

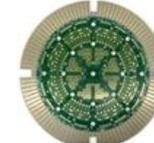
· 5G Mobile 用 (C/M, Wearable, Cable 用) Rigid-Flex 기판



MLB



Repeater (5G)



Probe Card



Automotive

· 5G Network 장비 및 반도체 Tester 등 MLB 기판

'20년 4분기 실적

- 매출 : 수출비중이 높은 당사의 특성상, 4분기의 환율 급락과 주요 고객사의 재고조정으로 매출이 크게 감소.
반도체용 패키지 및 모바일용 기판이 상대적으로 영향을 더 받음
- 수익 : 외형적 매출 감소와 더불어, 내부적으로는 신공장 Set-Up에 따른 원가부담 및 모바일 사업의 수익성 회복지연, MLB의 신규물량 확보 부진으로 손실기록.

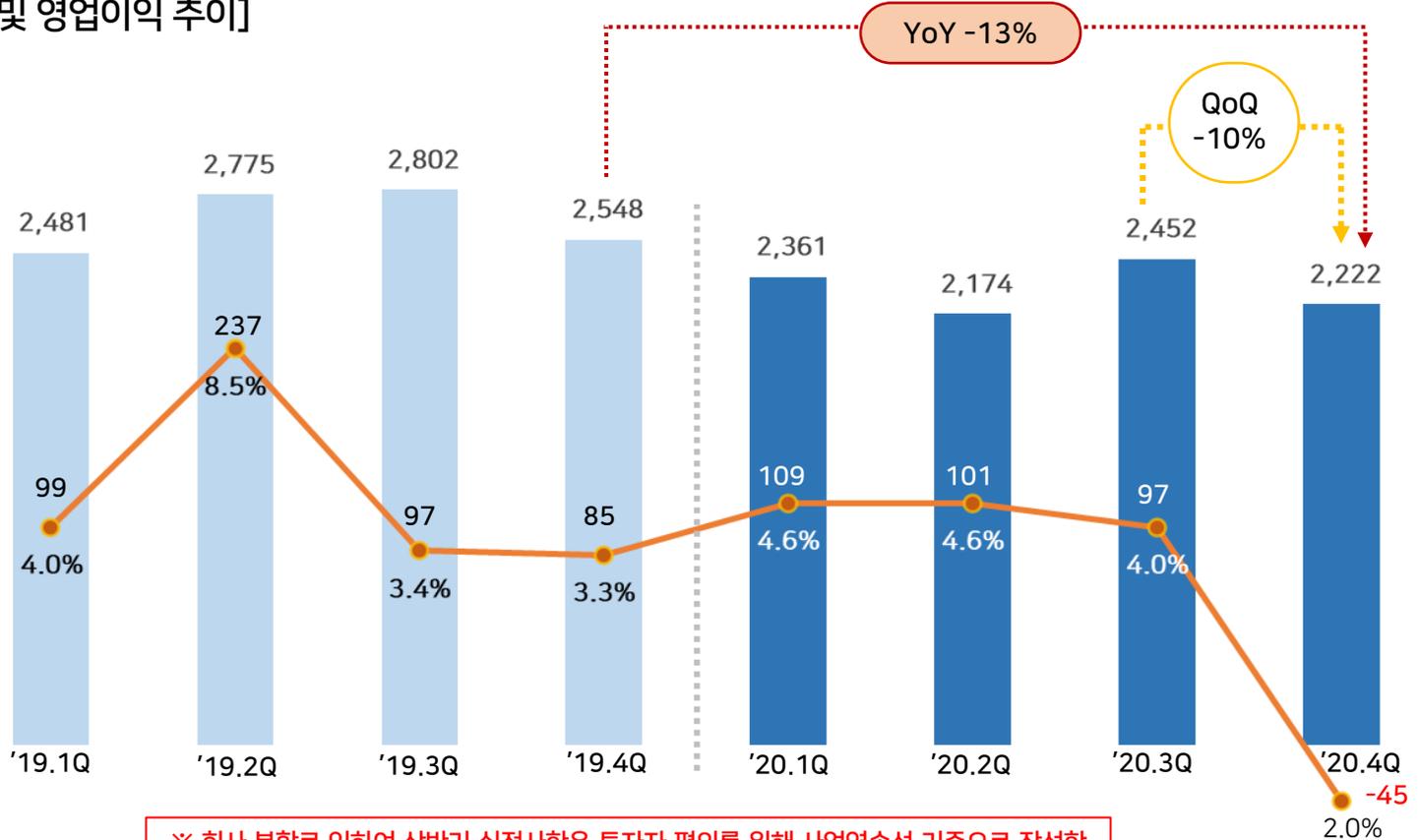
[분기별 매출액 및 영업이익 추이]

단위: 억원, %

■ 매출액

● 영업이익(율)

[별도기준]



※ 회사 분할로 인하여 상반기 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

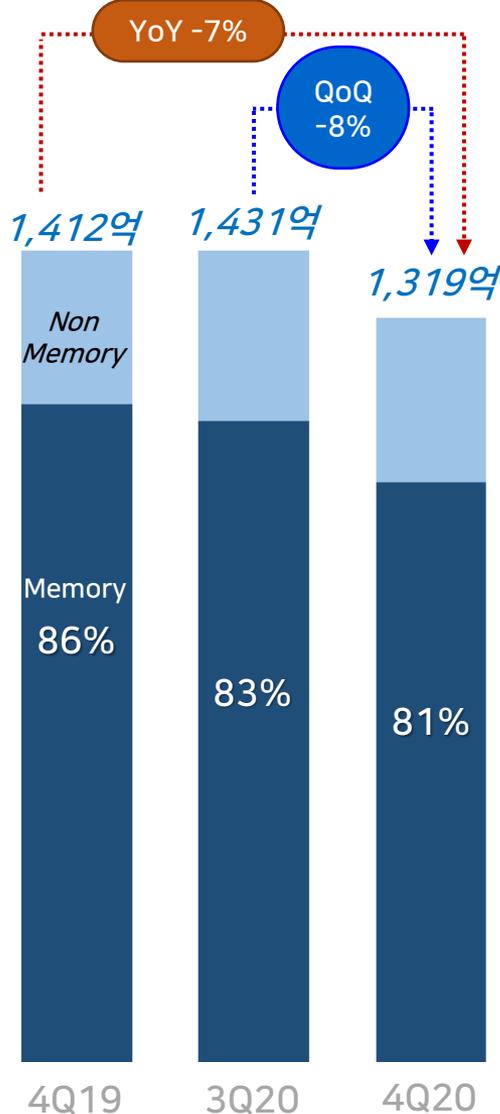
BGA / Flip Chip

'20년 4Q 실적 및 '21년 1Q 예상

[PKG부문]

단위: 억원, %

비메모리
메모리



['20년 4분기 실적]

고객사 재고조정 및 환율하락

- 경쟁사 화재에 따른 대응물량 수주 및 글로벌 고객 확보
- GDDR (5, 6) 수요 증가세
- DDR5 실적증가 및 21년 하반기 본격확대 전망
- 비메모리(fcBGA)에 대한 글로벌 고객 개발의뢰 증가

['21년 1분기 예상]

적극적 수주 확대에 따른 빠른 실적회복 전망

- 모바일용 LPDDR5 물량 증가
- fcBGA 신공장 Set-up 마무리 전망
- 글로벌 비메모리 시장 대응을 위한 fcBGA 추가투자
- 하반기 진입 목표로 전장용 비메모리 개발

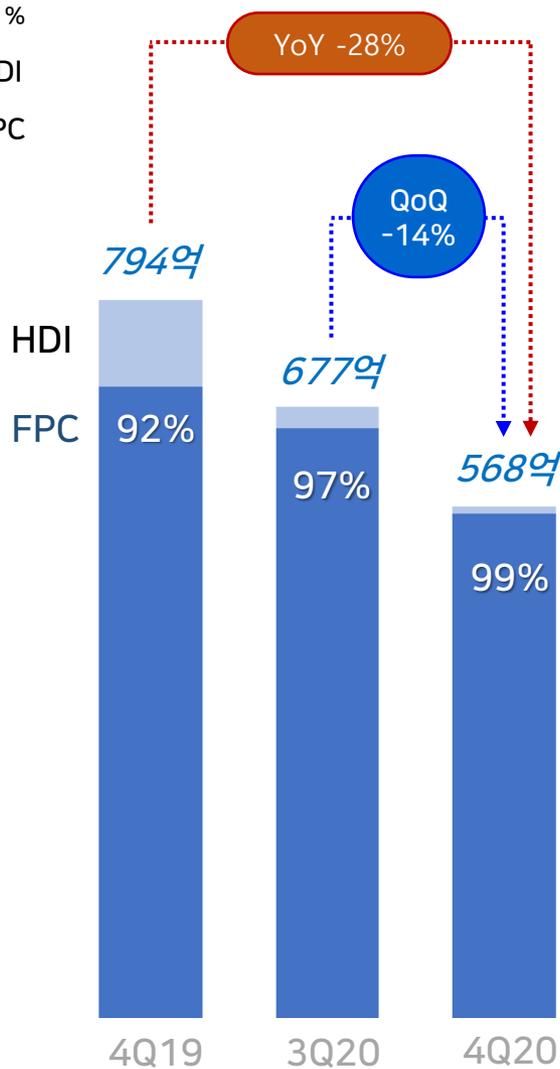
※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

Module SiP Div. '20년 4Q 실적 및 '21년 1Q 예상

[Mobile 부문]

단위: 억원, %

HDI
FPC



['20년 4분기 실적]

전방산업 수요감소 및 환율하락

- 상반기 시장 경쟁에 따른 ASP 하락으로 손실지속
 - 단, 신규물량 수주를 통한 ASP 개선 추이
- ※HDI실적 : 재고 매출 (공장은 20년 상반기 가동중단)

['21년 1분기 예상]

공정효율화 및 신규물량으로 수익 회복 기대

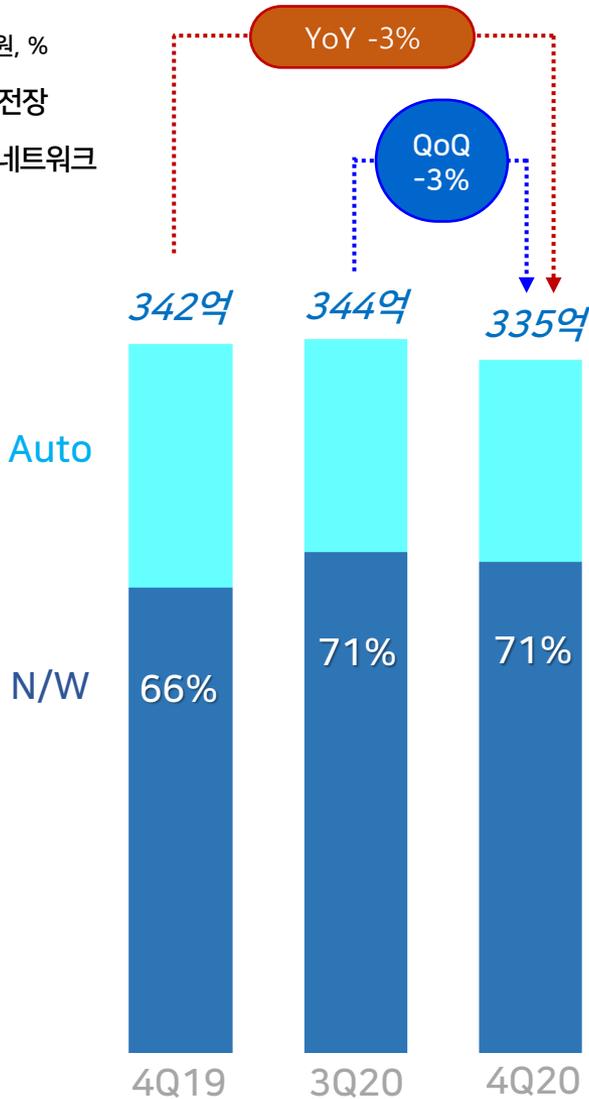
- 공정 효율화로 원가경쟁력 강화 및 신규 모델 확대를 통한 실적개선
- 가상화폐, 웨어러블 기기 등

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

MLB Div. '20년 4Q 실적 및 '21년 1Q 예상

단위: 억원, %

■ 전장
■ 네트워크



['20년 4분기 실적]

물량확대 → 계절적 수요감소 및 환율영향 최소화

- 코로나에 의한 전방시장 위축에 따른 회복지연
- 주요고객사를 통해 북미 네트워크고객向 물량수주 연말부터 생산대응.
- 반도체 검사장비 관련 물량 증가세 유지

['21년 1분기 예상]

사업성 개선으로 수익확보에 주력

- 반도체용 검사장비, Probe Card 물량 증가
- 5G 광통신 네트워크 물량 확대
- 공정 효율화 및 제품 MIX개선으로 수익 개선

※ 회사 분할로 인하여 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

요약재무제표 (별도기준)

[재무상태표]

단위:억원	[분할 전]	[분할 후]
구분	19.12	'20.12
유동자산	5,068	2,526
현금 및 현금성자산	413	204
금융상품	1,901	2
채권 등	1,678	1,362
비유동자산	6,790	5,448
자산총계	11,858	7,974
유동부채	1,377	1,447
비유동부채	102	100
부채총계	1,479	1,547
자본금	407	257
자본총계	10,378	6,427
부채비율	14%	24%

[손익계산서]

단위:억원	[분할 전]	[분할 후]
구분	2019	공시실적 2020
매출액	10,605	6,144
BGA/FC (PKG)	5,020	3,634
Module SiP (mobile)	4,010	1,632
MLB	1,575	878
영업이익	518	119
(%)	4.9%	1.9%
세전이익	850	-120
당기순이익	676	-115

※ 당사 2020년도 경영실적은 20년 5월 인적분할 되어, 5월~ 12월까지 8개월 분만 표기됨을 밝힙니다.

2020 ESG 주요현황



2020년도 당사 ESG 평가등급은 **종합 'A' 등급** 으로 우수한 지속가능 경영체제를 구축하고 있습니다.



E

환경경영인증

ISO14001 보유

환경 경영 조직

실무 조직 보유

환경 정보 공개

환경정보공개시스템 공개
홈페이지 공개

환경 교육

임직원 대상 환경교육 실시



S

사회공헌

사회공헌프로그램 운영

공정거래

공정거래 실천 프로그램 운영

협력사 지원

협력사 지원 프로그램 운영

인권보호

인권침해 예방 프로그램 운영
인권영향평가 실시



G

이사회 운영 실적

직전 1년간 16회 개최

배당

1주당 300원
현금 배당성장률 31%

감사기구

상근감사 선임

ESG 등급공개

전체 4개(E/S/G/ESG) 등급 중 4
개 등급을 투자자에게 공개

※ ESG등급은 2020년도 KCGS (한국기업지배구조원) 평가결과에 근거합니다

- 감사합니다 -